

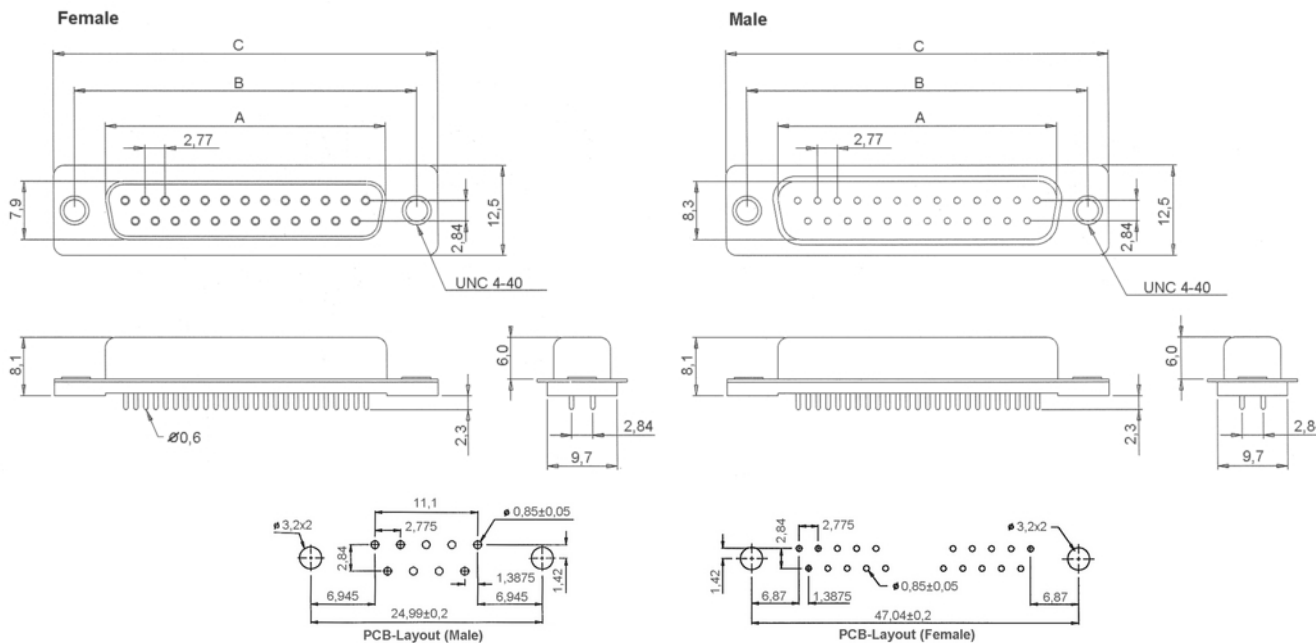
D-SUB-Steckverbinder - Einlötstift 180° - Notebook-Version D-SUB-Connector - Dip Solder Contact - Straight - Notebook Type

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold plated over nickel
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 15mΩ
Contact Resistance	< 15mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ω
Spannungsfestigkeit	1000V _{AC}
Test Voltage	1000V _{AC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Wave soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS



Contacts	Terminal Code	A	B	C
25	2	38,30	47,10	53,10
09	1	16,92	25,00	30,80

Series

425

Contacts*

25

09 Für Stift verfügbar
Available for male type
25 Für Buchse verfügbar
Available for female type

Terminal*

2

1 Stift
Male
2 Buchse
Female

Quality*

3

GK 1 Min. 500 Zyklen
Quality class 1: 500 cycles min.
GK 2 Min. 200 Zyklen
Quality class 2: 200 cycles min.
GK 3 Min. 50 Zyklen
Quality class 3: 50 cycles min.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave-Soldering Information

Wellen-Lötverfahren Wave-Soldering

Bauteile sollten bei 260°C für max. 5 Sekunden verarbeitet werden.
Items should be soldered at 260°C for max. 5 seconds.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:
Recommended Reflow-Soldering profile:

